

SC86CWG4（光能動部品） web 会合出席報告

日本電信電話株式会社

下小園 真

抄録：3 回に分割した WebEx 会議方式で開催された。25 件の文書メンテナンス審議および 4 件の回覧文書に関する議論が行われた他、PIC に関するプレゼンテーション、3 件の新規提案が行われた。

1. 会合情報

- 1.1 開催日 2020 年 10 月 20 日（火）、21（水）（日本時間）
- 1.2 開催場所 WebEx による開催
- 1.3 参加国 9 か国 20 名（米国 2、カナダ 2、英国 1、イタリア 1、フランス 1、韓国 1、中国 3、シンガポール 1、日本 8）
- 1.4 出席者 磯野（富士通オプティカルコンポーネツ）、岡村（グローバルプラン）、小倉（PETRA）、河合（NTT）、渋谷（白山）、下小園（NTT）、増田（光協会）、森（横河計測）

2. 会合出席報告と今後の方針

2.1 光能動部品製品規格（62148 シリーズ）

(1) IEC 62148-15/Ed.3（パッケージおよびインタフェース標準 第 15 部：VCSEL）

CDV コメント解決が行われた。日本から 9 件、中国から 5 件のコメントが寄せられた。日本からのコメントは 2 件を除き合意という回答であったが、その内、表の分割時の表題再記載に関してはエディター判断とした。またプロジェクトリーダーが前文に改訂の項目を列記する事に否定的であったが、中国からのコメントがテクニカルな内容を含むため、それらの変更点も含めて前文に列記する事で合意した。

(2) IEC 62148-21 Ed.2（パッケージおよびインタフェース標準 第 2 1 部：FBGA および FLGA の電気インタフェース）【日本担当】

CDV 文書の説明を行った。会合後 12 月にコメント締切があり、エディトリアルコメント 2 件のみであったため FDIS をスキップして IS となる事が決定された。

2.2 光能動部品性能標準（62149 シリーズ）

(1) IEC 62149-3/Ed.3（変調器集積型光送信器（40 Gbit/s 級）の性能標準）【日本提案】

2020 年 7 月 7 日に IS 発行されたが、表 6 の“Fibre pull”に関して修正が必要な状況であったため、対応案に関してプレゼンテーションを行った。Corrigendum、Amendment、改訂という選択肢があったが Corrigendum にて対応する方針を主張した。Corrigendum 発行の条件として、現行の規格で安全性に問題がある事の立証が必要とのコメントが 86C セクレタリからあったため、現行の規格でファイバピグテールにバッファファイバや樹脂被覆ファイバを用いた場合、負荷過重となる

ため破損する可能性がある」と主張し合意を得た。セクレタリに Corrigendum を提出しておき、今後 Corrigendum 発行の手続きに入る予定となっている。

- (2) IEC 62149-5/Ed.2 (光能動部品性能標準 第5部：半導体レーザー駆動回路及びクロックデータ再生回路内蔵 ATM-PON 用光トランシーバ)【日本提案】

2020年8月18日に IS 発行されたため本会合ではステイタスの確認のみであった。

2.3 試験及び測定方法関連 (62150 シリーズ)

- (1) IEC 62150-6 Ed.1 (光能動部品試験測定法 第6部：ユニバーサルメザンボード)

NP コメント解決が行われた。コメントは日本からの 15 件のみであった。JP1 コメントの文書の構成についての議論が行われた。本文書は 62150 シリーズ (試験及び測定方法) として回覧されているが、内容的にはパッケージ形状 (62148 シリーズ) であったり、性能標準 (62149 シリーズ) や技術情報 (TR) が混在していたため、日本からは内容ごとに分離する提案を行っていた。これらの内容について会合で議論したが、本件の規格に対応する製品があるわけではないため、従来の 62148 シリーズとして文書化する事は適切でなく、他にも適切な既存の文書群が存在しないため、本件については 62150 シリーズとして文書化し、内容的には試験及び測定方法に重点が置かれた内容にする事が合意された。

2.4 信頼性関連 (62572 シリーズ)

- (1) IEC/TR 62572-4 Ed.2 (信頼性 第4部：レセプタクル型光送受信器の光コネクタ端面清掃方法のガイドライン)【日本担当】

2020年9月8日に TR 発行された事が確認された。

2.5 メンテナンス文書

25 件のメンテナンス審議が行われた。基本的に安定期日の 2 年延長が決定されたが、それ以外の決定がなされたものを以下に示す。

- (1) IEC 62007-1 Ed.3 (光伝送用半導体レーザー 第1部：通則)【日本担当】

Normative reference の IEC 60747-5-1 が withdrawn となっているため改訂を提案し、合意された。

- (2) IEC 62148-12 Ed.1 (パッケージおよびインタフェース標準 第12部：同軸 RF コネクタ付きレーザー発振器)【日本担当】

前文に記載の IEC 62148 シリーズの文書体系が現状と一致していないため改訂を提案した。小規模な変更であれば Amendment でも対応可能とのコメントがあったが、発行の 2004 年から 15 年以上も経過しているため、全面的に見直す事で合意された。

- (3) IEC 62148-17 Ed.1 (パッケージおよびインタフェース標準 第17部：二重同軸高周波コネクタ付き送受信器)【日本担当】

SC46F にて議論中の同軸コネクタ (SMPM) に関する文書の進行状況が CDV であったため現状では改版に着手できない状況。本文書については安定期日を 1 年延長する事で合意された。

(4) IEC 62148-21 Ed.1 (パッケージおよびインタフェース標準 第2 1部: FBGA および FLGA の電気インタフェース)【日本担当】

本文書は Ed.2 が進行中であり現在 CDV 回覧中であるため、安定期日の1年延長を提案し合意された。

(5) IEC 62149-4 Ed.2 (性能標準 第4部: ギガビットイーサ用 1300nm 送受信器)【日本担当】

Optical output power (multimode fibre)の最大値が-3.5 dBm になっており、この値が IEEE 802.3-2015 で規定されている-3.0 dBm と一致していないため、改訂を提案し合意された。

(6) IEC TR 62572-2 Ed.1 (信頼性関連 第2部: レーザモジュールの劣化に関するテクニカルレポート)【日本担当】

本文書は信頼性に関するテクニカルレポートで、同技術分野において近年進展があまりないため安定期日 10 年を提案し合意された。

3. 特記事項

(1) 光トランシーバの Class 1/ 1M レベルの計算方法に関する新規技術資料の提案を日本から行った。

(2) 韓国から RoF モバイルフロントフォウル向け DFB レーザ TOSA に関する新規提案が行われた。

(3) 中国から 25 Gbit/s 直接変調レーザのパッケージ標準に関する新規提案が行われた。

(4) シンガポールの CompoundTek 社から PIC のオンウェハ検査に関するプレゼンが行われた。

(5) 86C/WG3 とのジョイント会合は開催されなかった。

4. 次回開催予定

開催予定日 2021年3月29日～4月9日 (うち4月2日～4月5日は休会)

開催予定地 web 会議

以上